

多機能成形技術による世界戦略

— NEW インモールド成形と精密一体成形の応用が拓く世界 —

(有)カワサキテクノリサーチ コンサルテーション・サービス事業部

本年の締め括りに選んだ KTR セミナー（金曜フォーラム）の主題は「多機能成形技術による世界戦略 - NEW インモールド成形と精密一体成形の応用が拓く世界-」です。

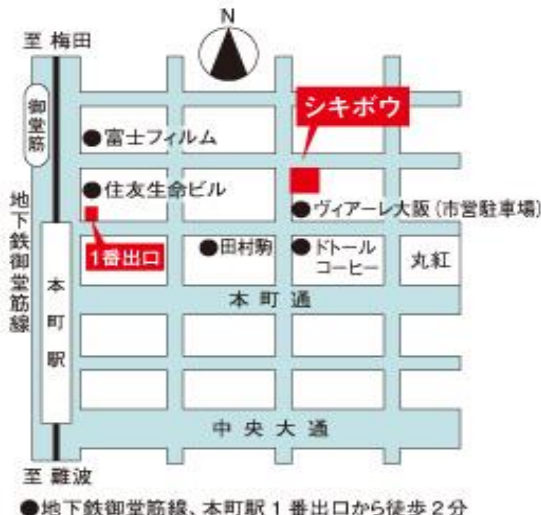
弊社は高機能、高性能樹脂の特性と応用に関するセミナーを持続的に主催してきました。これらの主な内容は適宜弊社の会報（カワサキテクノ短信）などで紹介しております。

さて今回は成形技術の最新情報にフォーカスしたいと考えました。大和化成の澤田会長からは「リチウムイオン電池に代表される精密・樹脂/金属一体成形技術の拡がり」と題するお話を頂き、富士加飾の杉野社長からは「インモールド成形が拓く世界とビジネスチャンス」とのテーマで問題提起をしていただきます。

弊社スタッフの高性能樹脂に関する話題提供（技術・市場動向のトピックス）も力が入っておりますので、どうか本年最終のセミナー（金曜フォーラム）への参加のほどよろしくお願いいたします。

概要

日	時：2014年12月5日（金）	12：30(開場)～17：00
場	所：大阪市中央区備後町3丁目2-6	シキボウホール 7F
定	員：50名（申込書先着順）	
参	加	費：コンサルテーション・サービス会員 15,000円 非会員 28,000円（税込み）



地下鉄御堂筋線「本町」駅下車
 <1> 番出口から徒歩約2分

※新大阪駅から本町駅迄は約20分です。

(プログラム概要)

1. 「高性能樹脂の技術動向と世界市場」

元東洋紡 エンプラ事業部 江口英樹<KTR>

13:00~13:45

現在編集の各種樹脂の全体動向を踏まえて、気になる高性能樹脂の技術と市場動向のトピックスに迫ってみたい。特に、弊社でも手掛けた放熱性や軽量化を意識した金属と各種樹脂接合の開発例に興味を持っている。

2. 「リチウムイオン電池に代表される精密・樹脂/金属一体成形技術の拡がりと展望」

大和化成株式会社 代表取締役会長 澤田明伸氏

13:50~15:00

電池部品のパイオニアとして製品に求められる機能向上に関わり、30年ものづくりを進めている。ガasketの要点は樹脂/金属接合技術にあり、ナノテクノロジーを応用した金属とプラスチックを結合・固着させることで機能開発・設計を手掛け、試作から量産までを取組んでいる。我が社が取組む接合技術についての私見を述べてみたい。

休憩 (10 分間)

3. 「インモールド成形が拓く世界とビジネスチャンス -IMD から IMR への展開による無限の可能性-」

富士加飾株式会社<元神戸製鋼所> 代表 杉野守彦氏

15:10~16:20

1. IMD (デザイン加飾) から IMR (加飾と機能性膜の付与)
2. 機能性膜 (耐熱、高硬度) による高性能樹脂への適応性拡大
3. 高機能樹脂の外装分野への適用性拡大

下記①、②、③項の技術導入による、新しいビジネスチャンスの到来と新しいビジネス実現のための諸条件

- ① IMR 金型技術の導入
- ② 高性能樹脂用金型技術の確立とホットランナー技術の導入
- ③ IMR 成型機の整備と成形技術の導入

4. 第二世代の IMR (Reinforcement) の開発開始
5. 低コストの量産技術ととらえた IMR 成形手法の今後の発展性

IMR 成形技術は、樹脂成形品に機能性を与えるのみならず、補強材の複合化手段としても有効。特に曲げ強度、弾性率は、成形品の表面にガラス繊維織布、炭素繊維織布を複合化することにより、PA、PPS、PE S 等超エンブラ樹脂の繊維強化材では達成できなかった金属材料を上回る機械的性能の達成が可能。(今回展開したいのは技術論だけではない。日本の技術の空洞化を挽回する戦略的提言である。)

講師を囲んでの交流会

16:30~17:00

..... 切り取り線

参加申込書 金曜フォーラム (2014/12/5 (金)) 大阪

「多機能成形技術による世界戦略

— NEW インモールド成形と精密一体成形の応用が拓く世界 —

・参加申込先: (有)カワサキテクノリサーチ コンサルテーション・サービス事業部

FAX: 06-6232-1056 or Email fwkw8067@mb.infoweb.ne.jp

・振込先/口座名: 三井住友銀行大阪中央支店 (有)カワサキテクノリサーチ 川崎 徹

口座 No: (普) 591475 (お振込料は各自でご負担ください。)

(会員・非会員) ○で囲って下さい。 ※お申込み後、参加証と請求書をお送り致します。

貴社名: _____ 部署名: _____

お名前: _____ TEL _____ FAX _____

ご住所 〒 _____

Email _____ 通信欄: _____